

锦州神工半导体股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2026 年 5 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

2026 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，本次调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—发行类第 6 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，并调整本次发行的拟募集资金规模。公司本次发行方案的具体调整内容如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	-	更新了“修订的董事会决议”、“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
2	第一节 本次向特定	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”

序号	章节	章节内容	主要修订情况
3	对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了“最新的第一大股东股份数及其持股比例”
4		八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了“修订的董事会决议”
5	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
6		二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了“三个募投项目的募集资金投资净额及项目审批进度”
7	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了“截至2026年6月30日的财务数据”
8		六、本次股票发行相关风险说明	更新了“截至2026年6月30日的财务数据”
9	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响、填补的具体措施及相关的主体承诺	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”、“2026年截至6月30日，研发人员人数及占比、专利数量”

本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年9月11日